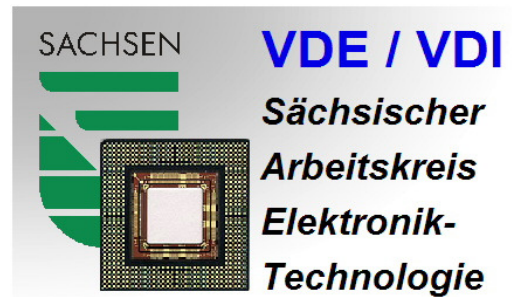


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann
oppermann@zmp.et.tu-dresden.de
Dipl.Ing. Dietmar Daniel
daniel@et.htw-dresden.de

Informationen im Internet: www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/



52. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Datum: Donnerstag, 12. Februar, 10:30 – 16:30 Uhr
Empfang und Anmeldung ab 10:00 Uhr

Thema: Prozessfehler vermeiden durch Qualität und Wissen

Gastgeber: Christian Koenen GmbH – HighTech Stencils, ZEVAC AG Deutschland



Ort: Christian Koenen GmbH, Otto-Hahn-Str. 24, 85521 Ottobrunn-Riemerling

Organisation: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer, Dietmar Daniel
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Elektrotechnik
Andreas Wilbert, Christian Koenen GmbH

Agenda

Stand: 2009-01-22

- 10:30 Uhr **Eröffnung des Treffens**
Prof. Reinhard Bauer, HTW Dresden, Obmann des Arbeitskreises
- 10:45 Uhr **„Kostenreduzierung durch moderne Schablonentechnik“**
Dipl.-Ing.(FH) Harald Grumm, Christian Koenen GmbH
- 11:30 Uhr **„Möglichkeiten der Prozesskontrolle im Rework“**
Janos Tolnay, ZEVAC AG
- 12:15 Uhr **„Fähigkeitsuntersuchungen beim Lotpastendruck“ (Arbeitstitel)**
Dr.-Ing. Heinz Wohlrabe, TU Dresden, IAVT, ZµP
- 13:00 Uhr *Mittagspause*
- anschließend **Besichtigung des Application Center und der
Schablonenfertigung der Christian Koenen GmbH**
- 15:15 Uhr **„Traceability in der Elektronikfertigung“ (Arbeitstitel)**
Rainer Ronniger, KARO Electronics Vertriebs GmbH
- ca. 16:00 Uhr *Abschlussdiskussion ...*